Partial English translation of Publication 3

JP-A-9-311340

[0021]

The producing method for the liquid crystal display device described in claim 8 is a method according to claim 1 or 4, wherein the sealant has a viscosity from 300 to 400 Pa·s. As the sealant has a viscosity within a range of from 300 to 400 Pa·s, the device can be used without a peeling or a non-crushing of the seal itself by the difference with the atmospheric pressure.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-311340

(43)公開日 平成9年(1997)12月2日

(51) Int.Cl.4		酸別記号	庁内整理番号	ΓI			技術表示簡所
G O 2 F	1/1341			G02F	1/1341		
	1/1339	5 0 O			1/1339	500	
		505				505	

審査請求 未請求 請求項の数 B OL (全 9 頁)

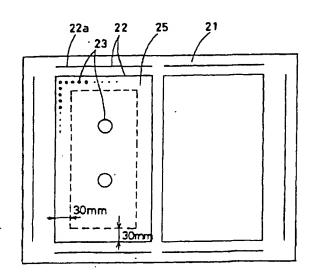
		(71)出國人 000005821
(21) 出題番号	特顯平8-125579	(71)出顧人 000005821 松下電器産業株式会社
(22) 出顧日	平成8年(1996)5月21日	大阪府門真市大字門真1006番地
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(72) 発明者 山田 聡
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
	·	(74)代理人 井理士 宮井 暎夫

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 均一なセルギャップが得られ表示品位の高い 液晶表示装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 配向処理を施した一対の電極付き基板21のうち少なくとも一方の基板21に液晶23を封止するためのシール材22を形成する工程と、少なくとも一方の基板にスペーサ材を配置する工程と、シール材22で囲まれた表示領域25に液晶23を滴下した供給する工程と、一対の基板21を減圧下で貼合わせる工程と、シール材22を硬化する工程とを含む液晶表示装置の製造方法であって、表示領域25をプロックに分割し、各プロック毎に決められた滴下パターンと滴下量の液晶23を滴下供給する。これにより、面内でのギャップが均一となり、表示品位の高いものとなる。



21… 蒸板 22…シール材 23… 液晶

【特許請求の範囲】

(S)

【請求項1】 配向処理を施した一対の電極付き基板のうち少なくとも一方の基板に液晶を封止するためのシール材を形成する工程と、少なくとも一方の基板にスペーサ材を配置する工程と、前記シール材で囲まれた表示領域に液晶を滴下供給する工程と、前記ー対の基板を減圧下で貼合わせる工程と、前記シール材を硬化する工程とを含む液晶表示装置の製造方法であって、前記表示領域をブロックに分割し、各ブロック毎に決められた滴下パターンと滴下量の液晶を滴下供給することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項2】 シール材の形成位置から少なくとも30mm以内の部分には、1点の滴下量が全滴下量の0.01%以内で液晶を滴下供給する請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項3】 シール材の形成位置から少なくとも30mm以内で滴下する液晶の隣接間距離が5mm以内である請求項2記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】 配向処理を施した一対の電極付き基板のうち少なくとも一方の基板に液晶を封止するためシール 20 材を形成する工程と、少なくとも一方の基板にスペーサ材を配置する工程と、前記シール材で囲まれた表示領域に液晶を滴下供給する工程と、前記・カの基板を減圧下で貼合わせる工程と、前記シール材を硬化する工程とを含む液晶表示装置の製造方法であって、前記シール材で囲まれた表示領域の各辺の外部に箱形のダミーシールパターンを形成し、この内部にスペーサ材を混入した液晶を滴下供給することを特徴とする液晶表示装置の製造方法

【請求項5】 箱形のダミーシールパターンに滴下供給 30 する液晶に混入するスペーサー材の平均粒径が、表示領域に配置されたスペーサー材の平均粒径よりも0.3 μmから2.0μmの範囲内で大きくした請求項4記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項6】 箱形のダミーシールパターンに滴下供給する液晶に混入するスペーサー材の配合量が0.5 w t%か53.0 w t%の範囲である請求項4または5 記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項7】 単純マトリクスの液晶表示装置のコモン側電極の終電部分に対する箱形のダミーシールパターン 40 に滴下供給する液晶に混入されたスペーサー材の平均粒径が、残り3辺に対する箱形のダミーシールパターンに滴下供給するスペーサー材の平均粒径よりも0.2μmから0.5μmの範囲で大きくした請求項4,5または6記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項8】 シール材の粘度が300Pa・sから400Pa・sの範囲である請求項1または4記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

. [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、多くの電子機器の表示装置として用いることのできる液晶表示装置の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、2枚の配向処理を施した基板間に 液晶を封じてなる液晶表示装置の製造方法として真空注 入工法が一般的に知られている。すなわち、少なくとも 一方の基板にスペーサー材を配置し、残り他方の基板に シール材を形成し、前配2枚の基板を貼合わせ、所定の セルギャップとなるように加圧し、シール材を硬化す る。その後必要な端子部分が残るように切断を行い、液 晶セルを作成し、真空注入により液晶をセル内に供給 し、セルギャップを決定するのに、液晶を注入後エアー 等の加圧手段を用いて液晶を押し出し、その後注入口を 封口する。

【0003】この製造方法では、注入するのに多量の液 晶を使用する、注入に時間がかかる、工程のライン化が 困難であるといった課題がある。こうした課題を解決す るのに、シール材形成工程と基板貼合わせ工程との間 に、液晶を滴下供給する滴下工法がある。この滴下工法 は、配向処理を施した電極付き基板の内、少なくとも一 方の基板にスペーサー材を混入した紫外線硬化型のシー ル材をスクリーン印刷等を用いて形成し、少なくとも一 方の基板にスペーサー材を散布配置し固着する。固着の 方法は、スペーサー材周囲に熱可塑性の樹脂をコーティ ングし、散布後所定の温度にてスペーサー材を固着する 方法がとられている。その後、前記シール材を形成した 基板に所定量の液晶を液体吐出装置を使用して所定の位 置に配置し、1 torr以下の減圧のもと前記スペーサ 一材を配置した対向する基板と貼合わせる。そしてシー ル材を紫外線硬化して液晶セルを作成する。

【0004】ここで、使用する液体吐出装置は、シリンジをパルスモーター、エア一等で加圧するもので、特に機械的制御が容易な点から、パルスモーターでシリンジを加圧する方法がとられている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、適下 工法は、真空注入工法に比べ液晶を供給する速度、安定 性という点で優れている。しかし、滴下工法は、任意の パターンで配置した各滴下ポイントに液晶を滴下する。 その後真空中で基板の貼合わせを行う。従って基板の貼 合わせ後、液晶を滴下した位置とそうでない位置と おって差が生じるために作製した液晶パネルは、滴下パターン状にむらが発生したものとなる。また、液晶のず りた力等から滴下状の電圧閾値むらが発生するといった 課題もある。

【0006】こうした滴下パターンに依存した面内のむらは、滴下ポイントを密に広い範囲にすることにより解 30 消できる。しかし基板を貼合わせた時にシール近傍に液

晶が滴下されていると、滴下された液晶の量にシールの つぶれ具合いが影響され、確かなシールギャップを得る ことができない。また、液晶の滴下量の影響がないよう シールから距離をとって液晶を滴下すると、シールと滴 下した液晶との間の部分は、大気圧差が直接働くため、 ギャップが低くなる。そのため額縁状にギャップむらが

【0007】通常、基板サイズが375mm×300m m×0.7 tmmで10.4インチサイズの液晶パネル を2丁取りする場合、その滴下点数は300点から50 O点で、滴下点の間隔は7mmから20mmである。こ のとき作成された液晶パネルは、電圧無印加の状態で滴 下パターン状にむらが見られる。また、シール近傍でも 適下パターンのピッチに相当してギャップむらが見られ

【0008】こうしたギャップむらは、滴下工法では、 基板の貼合わせ工程を減圧下で行い、液晶パネルのギャ ップ形成を大気圧差を利用しているために、液晶の存在 する所と、そうでない所でのギャップ差が生じることが 原因となっている。特にシール近傍では、シールを境界 20 にパネル面内、面外での大気圧差が直接かかることから 発生するシールの浮きや、液晶の展延具合いによる基板 のストレスによるギャップむらといったように、所定の ギャップを得ることが困難である。

【0009】このようにシール材の近傍では、滴下した 液晶の量、展延具合い、そしてパネル内圧と外圧の差の 影響から、基板へのストレスが集中しやすくギャップむ らとなりやすいといった課題が生じる。特に、基板の薄 型、大型化に伴いギャップむらが発生しやすい傾向にな る。また、単純マトリクスの場合では、コモン側電極の 30 終電側では、電極が形成されていないため、その他の部 分に比べ電極部分だけギャップが低くなっている。シー ル部分のギャップの制御は、シール材中に混入するスペ ーサー材によっているので、前記コモン側の終電部分の ギャップ差を埋めることはできない。従って液晶パネル の各辺によりギャップ差が生じるといった課題が生じ る。

【0010】こうした配線パターンによる表示むらは、 電極のダミーパターンを設けることにより解消できる が、ダミーパターンを設けることにより電極の静電破壊 40 がおこり、歩留まりの低下となる。したがって、この発 明の目的は、均一なセルギャップが得られ表示品位の髙 い液晶表示装置の製造方法を提供することである。

[0011]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の液晶表示 装置の製造方法は、配向処理を施した一対の電極付き基 板のうち少なくとも一方の基板に液晶を封止するための シール材を形成する工程と、少なくとも一方の基板にス ペーサ材を配置する工程と、シール材で囲まれた表示領 域に液晶を滴下した供給する工程と、一対の基板を減圧 50 一ルパターンを形成し、この内部にスペーサ材を混入し

下で貼合わせる工程と、シール材を硬化する工程とを含 む液晶表示装置の製造方法であって、表示領域をブロッ クに分割し、各ブロック毎に決められた滴下パターンと 商下量の液晶を適下供給することを特徴とするものである。

【0012】シール近傍に液晶が滴下されていると、滴 下された液晶の量にシールのつぶれ具合いが影響され、 確かなシールギャップを得ることができず、また液晶の 商下量の影響がないようシールから距離をとって液晶を 滴下すると、シールと滴下した液晶との間の部分は、大 気圧差が直接働くためギャップが低くなり、ギャップむ らが発生するが、シール材で囲まれた表示領域をブロッ クに分割し、各ブロック毎に決められた滴下パターンと **滴下量の液晶を滴下供給するので、面内でのギャップが** 均一となり、表示品位の高いものとなる。

【0013】請求項2記載の液晶表示装置の製造方法 は、請求項1において、シール材の形成位置から少なく とも30mm以内の部分には、1点の滴下量が全滴下量 の0.01%以内で液晶を滴下供給するものである。こ のように、シール材の形成位置から少なくとも30mm 以内の部分には、1点の商下量が全滴下量の0.01% 以内で液晶を滴下供給することにより、シール際が髙め になって見えることはなく、シール浮き、基板のうねり 等による、シール近傍でのギャップむらを効果的に抑え ることができる。

【0014】請求項3記載の液晶表示装置の製造方法 は、請求項2において、シール材の形成位置から少なく とも30mm以内で滴下する液晶の隣接間距離が5mm 以内である。このように、シール材の形成位置から少な くとも30mm以内で滴下する液晶の隣接間距離が5m m以内とすることにより、シール際で液晶の存在しない ところはなくなり、シール浮き、基板のうねり等によ る、シール近傍でのギャップむらをさらに効果的に抑え ることができる。

【0015】請求項4記載の液晶表示装置製造方法は、 配向処理を施した一対の電極付き基板のうち少なくとも 一方の基板に液晶を封止するためシール材を形成する工 程と、少なくとも一方の基板にスペーサ材を配置する工 程と、シール材で囲まれた表示領域に液晶を滴下供給す る工程と、一対の基板を減圧下で貼合わせる工程と、シ 一ル材を硬化する工程とを含む液晶表示装置の製造方法 であって、シール材で囲まれた表示領域の各辺の外部に 箱形のダミーシールパターンを形成し、この内部にスペ 一サ材を混入した液晶を滴下供給することを特徴とする ものである。

【0016】シールで封止された内部と外部との大気圧 差による影響から、シール材の近傍では、基板へのスト レスが集中しやすくギャップむらとなりやすいが、シー ル材で囲まれた表示領域の各辺の外部に箱形のダミーシ

た液晶を滴下供給するので、基板内の大気圧差が抑えら れるため、滴下した液晶の展延具合い、基板のストレス 等による、シール材の浮きやシール近傍での基板のうね りを解消できる。

【0017】請求項5記載の液晶表示装置の製造方法 は、請求項4において、箱形のダミーシールパターンに 商下供給する液晶に混入するスペーサー材の平均粒径 が、表示領域に配置されたスペーサー材の平均粒径より も 0. 3 μ m か 6 2. 0 μ m の 範囲内 で大きくしたもの である。このように、箱形のダミーシールパターンに滴 10 下供給する液晶に混入するスペーサー材の平均粒径が、 表示領域に配置されたスペーサー材の平均粒径よりも O. 3 μ m から 2. 0 μ m の範囲内で大きくしたので、 シール際のギャップが低くなることはなく、均一なギャ ップを形成することができる。

【0018】請求項6記載の液晶表示装置の製造方法 は、請求項4または5において、箱形のダミーシールパ ターンに滴下供給する液晶に混入するスペーサー材の配 合量が0. 5wt%から3. 0wt%の範囲である。ス ペーサ材の粒径に標準偏差があり、ある量を越えると、 平均粒径の位置がずれてシール際のギャップが高くなる ので、箱形のダミーシールパターンに滴下供給する液晶 に混入するスペーサー材の配合量が0.5wt%から 3. 0wt%の範囲とすることにより、電極パターンに 依存したギャップむらが発生することを抑えることがで きる。

【0019】請求項7記載の液晶表示装置の製造方法 は、請求項4、5または6において、単純マトリクスの 液晶表示装置のコモン側電極の終電部分に対する箱形の ダミーシールパターンに滴下供給する液晶に混入された 30 スペーサー材の平均粒径が、残り3辺に対する箱形のダ ミーシールパターンに滴下供給するスペーサー材の平均 粒径よりも0、2μmから0、5μmの範囲で大きくし たものである。

【0020】単純マトリクスの液晶表示装置のコモン側 電極の終電部分は電極が形成されていないため、その他 の部分に比べ電極部分だけギャップが低くなっている が、終電部分に対する箱形のダミーシールパターンに滴 下供給する液晶に混入されたスペーサー材の平均粒径 が、残り3辺に対する箱形のダミーシールパターンに商 40 下供給するスペーサー材の平均粒径よりも0.2μmか 50. 5 μ mの範囲で大きくしたので、この部分のギャ ップが低くなることはなく、均一なギャップを形成する ことができる。

【0021】請求項8記載の液晶表示装置の製造方法 は、韻求項1または4において、シール材の粘度が30 OPa·sから400Pa·sの範囲である。このよう に、シール材の粘度が300Pa・sから400Pa・ s の範囲であるので、大気圧差によりシール自身が浮い たり、またつぶれないといったことがなく使用すること 50 る。また、シール近傍の1点の滴下量は総量の0.01

ができる。

100221

【発明の実施の形態】この発明の第1の実施の形態の液 晶表示装置の製造方法を図1および図2に基づいて説明 する。図2は、滴下機を示す正面概略図である。液晶を 吐出するためのマイクロシリンジ11がフレーム15に 固定されている。シリンジ11の容量は250μ1で、 3本並列に配置され、先端に針12が付いている。針1 2の内径が大きいと少量での液晶の吐出が難しく、配向 処理を施した基板21に針先を接触させればならないた め、場合により配向膜に傷をつける恐れがある。そのた め、針の内径が0.7mmのものを使用した。そしてフ レーム15上部には、ステッピングモータ14があり、 シリンジ11を押すための加圧板13と連結されてい る。これにより、ステッピングモータ14に送られたパ ルス数だけ加圧板13がシリンジ11を押し進め、シリ ンジ11内の液晶23を針12の先から吐出する。

6

【0023】また、基板21は通常の液晶用ソーダガラ スでサイズが375mm×300mm×0.7tmmで 電極のパターニングされていないもの、ギャップを形成 するためのスペーサー材は、平均粒径が6μmで標準偏 差が O. 23 μmの樹脂ビーズで周囲を熱可塑性樹脂で コーティングしたもので散布密度が130個/mm²、 液晶材料は25℃での粘度が18cpsのネマチック液 晶、シール材22は紫外線硬化型のアクリル樹脂で25 °Cでの粘度が350Pa・sで、粒径が6. 1μmのガ ラス繊維を1.5wt%混合したものを使用した。

【0024】つぎに、この実施の形態の液晶表示装置の 製造方法について説明する。図1に示すように、配向処 理を施した一対の電極付き基板21のうち少なくとも一 方の基板21に液晶23を封止するための紫外線硬化型 シール材22を形成する。図1のシールパターンはパネ ルサイズが10. 4インチ (219. 2mm×85. 0 mm) で2丁取りの場合を示している。シール材22の ダミーパターン22gは、基板端面から7.5mm内側 の位置で、それぞれパネルの辺の長さに相当している。 つぎに、少なくとも一方の基板21にスペーサ材を配置 し、シール材22で囲まれた表示領域25に液晶23を 滴下する。このときステッピングモータ14にてピスト ンに印加されたパルス分だけ押すことにより液晶23を 吐出する。液晶23の吐出量は、印加されるパルス数で 決定する。

【0025】また、液晶23を滴下する際、表示領域2 5をブロックに分割し、各プロック毎に決められた滴下 パターンと滴下量の液晶23を滴下供給する。図1の滴 下パターンはシール近傍から30mmの領域内が、5m mピッチで滴下点数が長辺 (219.2mm) 側で1列 129点で5列、短辺 (85.0mm) 側で1列16点 で5列、パネル中央付近に2点滴下した場合を示してい

%に相当する20パルスで行った。なお、1点の滴下量 が0.05%に相当する100パルスの場合も行った。 【0026】この後、一対の基板21を減圧下で貼合わ せ、紫外線でシール材22を硬化する。 基板21の貼合 わせ条件は0.8 torrで行い、その後のギャップ出 しは大気圧で行った。また、図3と図4は異なる滴下パ ターンを示す。図3はシール近傍から20mmの領域内 が、5mmピッチで滴下点数が長辺側で1列129点で 3列、短辺側で1列16点で3列、パネル中央付近に2 点滴下した場合の滴下パターンを示す。シール近傍の1 点の滴下量は、図1の場合と同様に総量の0.01%に 相当する20パルスで行った。図4は10mmピッチで 滴下点数が450点の場合の滴下パターンを示す。

【0027】このようにして作成された液晶パネルの外 観評価を行った結果、図1で示す滴下パターンでは、シ ール近傍での1点の滴下量が20パルスの場合ではシー ル際ではギャップむらは見られないが、1点での滴下量 を100パルスとした場合は、シール際がすべて髙めに なって見える。また、シール近傍での額縁むらも電圧無 印加の状態では見られない。しかし電圧を印加すると薄 20 く閾値電圧むらが見られる。

【0028】これに対し、図4に示す滴下パターンで は、シール近傍では、滴下ピッチに相当したギャップむ らが発生し、面内でも所により滴下パターンに相当する むらが発生している。次に、図3で示す滴下パターンで は、シール際ではギャップむらは見られないが、シール 材22から30mmから40mm内側で額縁状にギャッ プむらが発生している。

【0029】このように、シール際から少なくとも30 mm以内の領域で滴下間隔が5mm以下で、1点の滴下 30 量が総量の0.01%以下であるなら、シール近傍での ギャップむらを解消できる。面内のむらに関しても、こ の実施の形態から、軽減していくことが可能である。例 えば、残されたパネル中央部の領域での滴下パターンと 滴下量を検討することにより十分均一なギャップのパネ ルを作成することができる。このとき滴下パターンとし ては、上下左右均等にすること、液晶 2 3 の滴下量は、 シール材22側程少な目にすることが必要である。

【0030】第2の実施の形態の液晶表示装置の製造方 法を図5ないし図8に基づいて説明する。この実施の形 40 4.5wt%と濃度を変えて混入した液晶42を滴下間 態では、単純マトリクスの電極をパターニングしてあ る。図5は液晶パネルのコモン側電極31bの給電側を 示す断面図であり、図6は終電側を示す断面図である。 通常使用される電極31は1TOで、その膜厚は0.2 μmから0.3μmである。電極31の上に配向膜32 が形成されている。また、シール際で均一なギャップを 出すためにシール材22中に混入されるスペーサー材3 4 の平均粒径は、面内に散布配置されているスペーサー 材 3 3 の平均粒径よりも0. 2 μ m から0. 3 μ m、つ まりセグメント側電極31aの厚み分だけ大きいものを 50 関係なく平均粒径が 6.5μmのものはシール際のギャ

使用する。しかし、図6からわかるようにコモン側電極 316の終電側では電極31が全く形成されていない部 分にシール材22を形成している。従ってこの部分だけ ギャップが他の辺よりも低くなっている。

【0031】また、滴下工法では、パネルの大型化、基 板35の薄型化に伴い、基板35内でシール材22で封 止された部分とそうでない部分との大気圧差が顕著にな り、シール材22の浮き、基板35にかかるストレスと いった問題が生じる。こうした問題を解決するのに、各 辺の外側に箱形のダミーシールパターンを形成し、この 内部に液晶を滴下し、基板貼合わせ後の基板内での加圧 差をなくすことにより均一なギャップを形成する方法が ある。この実施の形態では、箱形のダミーシールパター ン41に任意の平均粒径を有するスペーサー材を混入し た液晶42を滴下することにより電極パターンによるギ ャップむらをなくしている。この場合、箱形のダミーシ ールパターン41は、それぞれ各辺の長さに対応した長 さで、セグメント、コモンとも電極端子から2mm離れ た位置から、基板35の端面から7. 5mmの位置にな るように形成されている。またコモン、セグメントとも 電極端子がない場合は、シール材22から3mm離れた 位置から形成している。

【0032】つぎに、この実施の形態の液晶表示装置の 製造方法について説明する。表示領域25内に、図1に 示す滴下パターンで液晶23を滴下し、図7に示すよう に、箱形のダミーシールパターン41の内部にスペーサ 材を混入した液晶42を滴下供給する。この液晶42に 混入したスペーサ材の平均粒径は、表示領域25に配置 されたスペーサ材の平均粒径よりも0.3μmから2. Ομπの範囲で大きくしてある。また、液晶 4 2 に混入 したスペーサ材の配合量はO. 5 w t %から 3. 0 w t %の範囲である。

【0033】ここで、図8に示すように、コモン側電極 31bの終電側にある箱形のダミーシールパターン41 には、残り3辺に対する箱形のダミーシールパターン4 1に滴下供給するスペーサー材の平均粒径よりも0.2 μ mから 0 . 5μ mの範囲で大きくし、かつ平均粒径が それぞれ6. 1 μ m、6. 3 μ m、6. 5 μ m のスペー サ材を0. 5wt%、1. 5wt%、3. 0wt%、

隔5mmで滴下する。

【0034】また、表示領域25内に、図1および図4 と同様の滴下パターンで液晶23を滴下し、箱形のダミ ・ 一シールパターン41には、図9および図10に示すよ うに、滴下間隔が5mmでそれぞれの箱形のダミーシー ルパターン41内に液晶23を滴下する。こうして作成 された液晶パネルの外観評価を行った結果、図8で示す ように、コモン側電極の終電部分にスペーサー材を混入 した液晶 4 2を滴下した場合は、スペーサー混合濃度に

ップが高くなっている。そして、平均粒径が 6. 1 μ m のものは、シール際のギャップが低くなっている。それらに対し平均粒径が 6. 3 μ m のもは、スペーサーの混合濃度が 4.5%のものでは、シール際のギャップが高くなっている。これは、スペーサー材の粒径に標準偏差があり、ある量を越えると、平均粒径の位置がずれるためと考えられる。こうして、コモン側電極の終電部分にある箱形のダミーシールパターン41内に平均粒径が6.3 μ m で濃度が 0.5 w t %から 3.0 w t %の範囲であれば、電極パターンに依存したギャップむらのな 10 い表示品位の高い液晶表示装置を提供できる。

【0035】また、図10の滴下パターンでは、面内の所々に滴下パターン状のむらは見られるが、シール近傍の基板35のうねりや、シール材22の浮きによるギャップむらは見られない。次に、図9に示す滴下パターンでは、面内、及びシール際でのギャップむらは見られない。しかし、図9および図10で示す滴下パターンでは、コモン側電極31bの終電部分でギャップが低い。これは、シール材22中に含まれているスペーサー材34の径が4辺とも同じだが、終電部分には、電極が無い20ためにギャップが低くなっている。

【0036】なお、上記実施の形態では、電極の段差を考慮したスペーサー径をあげたが、例えば、カラーフィルター付きの基板等に対しては、そのカラーフィルター部分の厚みを考慮してスペーサー材の平均粒径を検討すれば問題ない。また、混合濃度もスペーサー材の標準偏差、ダミーパターンの形成位置等により検討を行うことが好ましい。また、シール材22は熱硬化型でもよい。【0037】

【発明の効果】この発明の請求項1記載の液晶表示装置 30 の製造方法によれば、シール近傍に液晶が滴下されていると、滴下された液晶の母にシールのつぶれ具合いが影響され確かなシールギャップを得ることができず、また液晶の滴下量の影響がないようシールから距離をとって液晶を滴下すると、シールと滴下した液晶との間の部分は、大気圧差が直接働くためギャップが低くなりギャップむらが発生するが、シール材で囲まれた表示領域をブロックに分割し、各ブロック毎に決められた滴下パターンと滴下母の液晶を滴下供給するので、面内でのギャップが均一となり、表示品位の高いものとなる。 40

【0038】請求項2では、シール材の形成位置から少なくとも30mm以内の部分には、1点の滴下量が全滴下量の0.01%以内で液晶を滴下供給することにより、シール際が高めになって見えることはなく、シール浮き、基板のうねり等による、シール近傍でのギャップむらを効果的に抑えることができる。請求項3では、シール材の形成位置から少なくとも30mm以内で滴下する液晶の隣接間距離が5mm以内とすることにより、シール際で液晶の存在しないところはなくなり、シール浮き、基板のうねり等による、シール近傍でのギャップむ50

10

らをさらに効果的に抑えることができる。

【0039】この発明の請求項4記載の液晶表示装置製造方法によれば、シールで封止された内部と外部との大気圧差による影響から、シール材の近傍では、基板へのストレスが集中しやすくギャップむらとなりやすいが、シール材で囲まれた表示領域の各辺の外部に箱形のグミーシールパターンを形成し、この内部にスペーサ材を混入した液晶を商下供給するので、基板内の大気圧差が抑えられるため、滴下した液晶の展延具合い、基板のストレス等による、シール材の浮きやシール近傍での基板のうねりを解消できる。したがって、滴下工法においておいてギャップの均一な表示品位の高い液晶表示装置を歩留りよく製造できる。また、パネルサイズ、基板サイズの大型化、基板の薄型化に伴う影響を解消することができ、汎用性の高い液晶表示装置が得られる。

【0040】請求項5では、箱形のダミーシールパターンに滴下供給する液晶に混入するスペーサー材の平均粒径が、表示領域に配置されたスペーサー材の平均粒径よりも0.3μmか62.0μmの範囲内で大きくしたので、シール際のギャップが低くなることはなく、均一なギャップを形成することができる。請求項6では、スペーサ材の粒径に標準偏差があり、ある量を越えると、平均粒径の位置がずれてシール際のギャップが高くなるので、箱形のダミーシールパターンに滴下供給する液晶に混入するスペーサー材の配合量が0.5wt%か63.0wt%の範囲とすることにより、電極パターンに依存したギャップむらが発生することを抑えることができる。

【0041】請求項7では、単純マトリクスの液晶表示装置のコモン側電極の終電部分は電極が形成されていないため、その他の部分に比べ電極部分だけギャップが低くなっているが、終電部分に対する箱形のダミーシールパターンに滴下供給する液晶に混入されたスペーサー材の平均粒径が、残り3辺に対する箱形のダミーシールパターンに滴下供給するスペーサー材の平均粒径よりも0.2μmか60.5μmの範囲で大きくしたので、この部分のギャップが低くなることはなく、均一なギャップを形成することができる。

【0042】請求項8では、紫外線硬化型シール材の粘度が300Pa・sから400Pa・sの範囲であるので、大気圧差によりシール自身が浮いたり、またつぶれないといったことがなく使用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の 製造方法における滴下パターンとシールパターンを示す 正面図である。

【図2】この発明の第1の実施の形態における液晶の滴 下機構の正面概略図である。

【図3】この発明の第1の実施の形態の変形例の滴下パターンとシールパターンを示す正面図である。

11

【図4】 比較例の滴下パターンとシールパターンを示す 正面図である。

【図5】単純マトリクス型の液晶表示パネルのコモン側電極の給電部分を示す断面図である。

【図6】単純マトリクス型の液晶表示パネルのコモン側電極の終電部分を示す断面図である。

【図7】この発明の第2の実施の形態の液晶表示装置の 製造方法における箱形のダミーシールパターンを形成し たシールパターンを示す正面図である。

【図8】この発明の第2の実施の形態における滴下パタ 10 ーンとシールパターンを示す正面図である。

【図9】この発明の第2の実施の形態の変形例の滴下パターンとシールパターンを示す正面図である。

【図10】この発明の第2の実施の形態の別の変形例の 簡下パターンとシールパターンを示す正面図である。

【符号の説明】

]] シリンジ 12 滴下用針 加圧板 1 3 ステッピングモーター 1 4 1 5 フレーム 配向処理を施した電極付き基板 2 1 2 2 液晶用シール材 液晶 23 セグメント側電極 3 1 a

12

31bコモン側電極32配向膜

33 スペーサー材

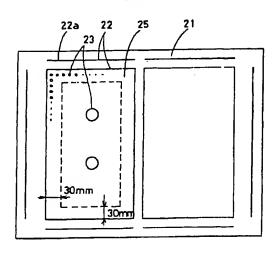
34 スペーサ材(ガラス繊維)

3 5 ガラス基板

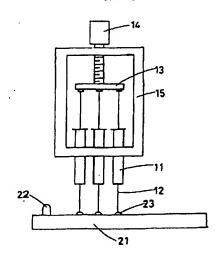
41 箱形のダミーシールパターン

42 スペーサー材混入液晶

【図」】

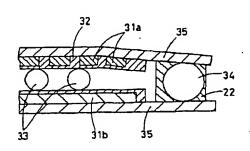


【図2】



21…基板 22…シール材 23…液晶

(図6)



[図3]

